



2020年8月7日

各 位

会社名	タツモ株式会社
代表者名	代表取締役社長 池田 俊夫 (コード番号：6266 東証第一部)
問合せ先	専務取締役管理本部長 亀山 重夫
電話番号	086-239-5000

## 弘塑科技股份有限公司との資本業務提携変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、弘塑科技股份有限公司（中華民国新竹市香山区中華路六段 89 号、以下「弘塑科技」といいます。）との資本業務提携につきまして、以下のとおり変更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

現在、両社は、資本業務提携に基づき半導体事業において、相互の事業発展と企業価値向上を目指して、業務上の交流を行っております。

両社は、今後とも従来どおりの業務提携関係を継続、維持することで合意しております。

#### 1. 資本業務提携内容の変更

両社は、2015年11月9日付で、台湾・中国での協業などによる事業の拡大を図ることを目的として資本業務提携契約を締結いたしました。しかしながら、その後、弘塑科技におけるグループ資本効率の見直しにより、資本提携変更についての打診があり、資本提携がなくとも業務提携効果を継続・強化することに関して、両社ともに、一切支障はないものと判断し、資本提携の一部見直しを行ったうえで、業務提携を継続することといたしました。

具体的には、弘塑科技が、同社が保有している当社株式の一部である発行済株式総数の 2.96% 相当の普通株式合計 400,000 株（以下「売却予定株式」といいます。）を売却し、残存する発行済株式総数の 5.9% 相当の普通株式 800,000 株の保有を継続していくことに関して、両社で合意いたしました。

弘塑科技は、売却予定株式の一部である 200,000 株を上限に、2020年8月24日に、ToSTNeT-1 により売付けの申込みを行う予定であります。当該売付けの申込みに対しましては、「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust））」（以下「BBT 制度」といいます。）および「株式給付信託（J-ESOP）」（以下「J-ESOP 制度」といいます。）の信託受託者であるみずほ信託銀行株式会社より、ToSTNeT-1 により買付けの申込みを行う可能性があるとの説明を受けております。

なお、BBT 制度および J-ESOP 制度に関する各信託への追加拠出につき、本日開示いたしました

株式給付信託（BBT および J-ESOP）への追加抛出に関するお知らせもご参照ください。

弘塑科技は、以上の ToSTNeT-1 を用いた取引により売却が成立した部分を除いた売却予定株式につきまして、2021 年 6 月末までに売却を予定しておりますが、相手先、手法については未定です。

## 2. 今後の見通し等

資本業務提携の見直しによる当社の 2020 年 12 月期業績に与える影響は軽微であります。また、今回の資本業務提携の変更にかかわらず、2015 年 11 月 9 日付で発表した業務提携の内容を含めて、当社と弘塑科技は従来どおり、業務提携関係を継続してまいります。

以 上